



产品规格书/Specification

产品/product:	氯化银银浆/ Ag/AgCl paste
料号/Part number:	01L-7211

- ※ 用于心电图, 脑电图等生物传感器电极
- ※ 优异的可延展性
- ※ 80~200℃加热固化
- ※ 陶瓷基板、PET、PC, 聚酯薄膜等片材
- ※ 印刷性良好

氯化银银浆主要特点

基材 Substrate	陶瓷基板、PET、PC, 聚酯薄膜等片材 Suitable for Ceramic, Pet, PI, Pc etc	
使用方法 Method of use	250-350 mesh stainless screen 250-350 目丝网印刷	
流平 Leveling	3-5min minutes at room temperature 室温下流平 3-5 分钟 (时间根据流平的实际情况决定)	
固化 Curing conditions	在恒温烘箱,或者持续热风 (以下条件选其一即可)	
	80℃	60 分钟/mins
	120℃	20 分钟/mins
	150℃	10 分钟/mins
180℃	5 分钟/mins	
Fineness 细度	≤5μm	FOG test
Viscosity 粘度	100-180Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。
固体含量 content	65-80%	银 Silver, Glue
附着力 Adhesion	无脱落 Not fall off	3M 600#胶带 90°拉 3M 600#Tape 90°Pull



适用范围/Application:

电极氯化银浆，用于心电图，脑电图等生物传感器电极。

基材 Substrate	陶瓷基板、PET、PC，聚酯薄膜等片材 Suitable for Ceramic, Pet, PI, Pc etc	
使用方法 Method of use	250-350 mesh stainless screen 250-350 目丝网印刷	
流平 Leveling	3-5min minutes at room temperature 室温下流平 3-5 分钟（时间根据流平的实际情况决定）	
固化 Curing conditions	在恒温烘箱,或者持续热风（以下条件选其一即可）	
	80℃	60 分钟/mins
	120℃	20 分钟/mins
	150℃	10 分钟/mins
	180℃	5 分钟/mins
Fineness 细度	≤5μm	FOG test
Viscosity 粘度	100-180Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT（博利飞）粘度计，转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。
固体含量 content	65-80%	银 Silver, Glue
附着力 Adhesion	无脱落 Not fall off	3M 600#胶带 90°拉 3M 600#Tape 90°Pull

保存条件，有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-15℃的环境温度下密封储存，有效期为产品发货之日起六个月。

The product shall be guaranteed for 6 months after shipping date, keep tightly under at 5-15℃

包装方式/Packaging method:

标准包装，1000g/罐，样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can, if you need sample to test, available 200g with small package.

生物电极测试电路常用材料

- ※ 用于心电图，脑电图等生物传感器电极
- ※ 优异的可延展性
- ※ 80~200℃加热固化
- ※ 陶瓷基板、PET、PC，聚酯薄膜等片材
- ※ 印刷性良好

料号	成份	主要特点，应用领域 Application field, Main feature
氯化银银浆 01L-7211	氯化银/银	<p>用于心电图，脑电图等生物传感器电极</p> <p>①可以丝网印刷，点胶，稀释后喷涂（需加专用稀释剂 ST1001）</p> <p>②在陶瓷、玻璃、PCB 等硬基材，PET、PC、PI 软基材上均可使用可提供优良的导电性和薄膜粘接性</p> <p>③有着良好的印刷性、抗氧化性，柔性和极强的附着力，可弯折，弯折后电阻不会有明显变化</p> <p>④薄膜开关、柔性印刷电路、键盘电路、屏蔽线路、多层线路印，射频干扰屏蔽、RFID、玩具、学习机电路等印刷和触点印刷等领域</p> <p>⑤80-120℃烘烤（最高可 200℃），peT 等高分子材料，低电阻，印刷，涂抹，固化后耐温 200℃以下，短暂 300℃以下</p>
银浆 01L-2211D	低温银浆	<p>①可以丝网印刷，点胶，稀释后喷涂（需加专用稀释剂 ST1001）</p> <p>②在陶瓷、玻璃、PCB 等硬基材，PET、PC、PI 软基材上均可使用可提供优良的导电性和薄膜粘接性</p> <p>③有着良好的印刷性、抗氧化性，柔性和极强的附着力，可弯折，弯折后电阻不会有明显变化</p> <p>④薄膜开关、柔性印刷电路、键盘电路、屏蔽线路、多层线路印，射频干扰屏蔽、RFID、玩具、学习机电路等印刷和触点印刷等领域</p> <p>⑤固化后耐温 200℃以下，短暂 300℃以下</p>
碳浆 08L23-011	碳浆	陶瓷基板、PET、聚酯薄膜等片材 在恒温烘箱 80-150℃，10-30 分钟
外层包封 09L-PET		用于 PET，PI 等柔性电路外层保护，蓝色，无色可选